

招商证券股份有限公司

关于江苏鑫华半导体科技股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）



住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

声 明

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（下称“《注册管理办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（下称“《保荐管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（下称“《上市规则》”）、《上海证券交易所股票发行上市审核规则》（下称“《审核规则》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）及上海证券交易所（下称“上交所”）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

（本发行保荐书如无特别说明，相关用语含义与《江苏鑫华半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（申报稿）》相同）

目 录

声 明.....	1
目 录.....	2
第一节 本次证券发行基本情况	3
一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍.....	3
二、发行人基本情况.....	4
三、保荐机构与发行人之间的关联关系.....	4
四、本保荐机构内部审核程序和内核意见.....	6
第二节 保荐机构的承诺	8
第三节 对本次证券发行的推荐意见	9
一、发行人已就本次证券发行履行了《公司法》《证券法》及中国证监会规定的决策程序.....	9
二、发行人符合《证券法》规定的发行条件.....	9
三、发行人符合《注册管理办法》有关规定.....	11
四、发行人符合《上市规则》规定的发行条件.....	14
五、发行人符合科创板定位的说明.....	15
六、发行人存在的主要问题和风险.....	18
七、发行人的发展前景评价.....	22
八、保荐机构、发行人在本次项目中直接或间接有偿聘请第三方的核查意见.....	23
九、对本次证券发行的推荐意见.....	25
附件:	27

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍

保荐机构	保荐代表人	项目协办人	其他项目组成员
招商证券股份有限公司	姜博、吴宏兴	赵国伟	汪军鹏、周长征、樊非凡、董丰田、罗文豪、刘李威、周天瑶、张墨涵、吕琛、付雨锋、袁振清

保荐代表人、项目组成员主要信息如下：

项目组	姓名	联系地址	电话	邮箱
保荐代表人	姜博	深圳市福田区福田街道福华一路111号	0755-82943666	jiangbo2@cmschina.com.cn
保荐代表人	吴宏兴	深圳市福田区福田街道福华一路111号	0755-82943666	wuhx@cmschina.com.cn
项目协办人	赵国伟	深圳市福田区福田街道福华一路111号	0755-82943666	zhaoguwei@cmschina.com.cn
其他项目组成员	汪军鹏	深圳市福田区福田街道福华一路111号	0755-82943666	wangjunpeng1@cmschina.com.cn
其他项目组成员	周长征	深圳市福田区福田街道福华一路111号	0755-82943666	zhoucz@cmschina.com.cn
其他项目组成员	樊非凡	深圳市福田区福田街道福华一路111号	0755-82943666	fanfeifan@cmschina.com.cn
其他项目组成员	董丰田	深圳市福田区福田街道福华一路111号	0755-82943666	dongfengtian@cmschina.com.cn
其他项目组成员	罗文豪	深圳市福田区福田街道福华一路111号	0755-82943666	luowenhao@cmschina.com.cn
其他项目组成员	刘李威	深圳市福田区福田街道福华一路111号	0755-82943666	liuliwei2@cmschina.com.cn
其他项目组成员	周天瑶	深圳市福田区福田街道福华一路111号	0755-82943666	zhoutianyao@cmschina.com.cn
其他项目组成员	张墨涵	深圳市福田区福田街道福华一路111号	0755-82943666	zhangmohan@cmschina.com.cn
其他项目组成员	吕琛	深圳市福田区福田街道福华一路111号	0755-82943666	lvchen@cmschina.com.cn
其他项目组成员	付雨锋	深圳市福田区福田街道福华一路111号	0755-82943666	fuyufeng@cmschina.com.cn
其他项目组成员	袁振清	深圳市福田区福田街道福华一路111号	0755-82943666	yuanzhenqing@cmschina.com.cn

(一) 保荐代表人近年主要保荐业务执业情况

1、招商证券姜博近年主要保荐业务执业情况如下：

项目名称	保荐工作	是否处于持续督导期间
概伦电子科创板 IPO	担任保荐代表人	是

项目名称	保荐工作	是否处于持续督导期间
科达制造主板非公开发行	担任项目协办人	否
芯原股份科创板 IPO	担任项目协办人、持续督导保荐代表人	否

2、招商证券吴宏兴近年主要保荐业务执业情况如下：

项目名称	保荐工作	是否处于持续督导期间
概伦电子科创板 IPO	担任保荐代表人	是
百普赛斯创业板 IPO	担任保荐代表人	是
芯原股份科创板 IPO	担任保荐代表人	否
西麦食品主板 IPO	担任保荐代表人	是

(二) 项目协办人赵国伟近年主要保荐业务执业情况

项目名称	保荐工作	是否处于持续督导期间
国博电子科创板 IPO	担任项目组成员	是

二、发行人基本情况

发行人名称	江苏鑫华半导体科技股份有限公司
注册地点	徐州经济技术开发区杨山路 66 号
注册时间	2015 年 12 月 11 日
联系方式	0516-83958888
业务范围	半导体材料、电子材料、高纯材料及副产品的研发、制造、销售及技术服务、咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品或技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；许可项目：检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
本次证券发行类型	首次公开发行 A 股股票并在科创板上市

三、保荐机构与发行人之间的关联关系

(一) 保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况

发行人无控股股东、无实际控制人。

经向上逐层穿透，保荐机构招商证券通过衍生品投资业务、子公司等主体间接持有发行人少量股份，累计间接持股比例低于千分之一。该等情况均为相关投资主体的市场化行为，不属于法律法规禁止持股的情形或利益冲突情形。

上述情况符合《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，不影响保荐机构和保荐代表人公正履行保荐职责，不影响保荐机构的独立性。

除上述相关情况外，截至本发行保荐书出具之日，保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有发行人或其重要关联方股份而影响保荐机构独立性的情形，也不存在影响保荐机构和保荐代表人公正履行保荐职责的情况。

保荐机构将安排子公司招商证券投资有限公司参与本次发行战略配售，具体按照上交所相关规定执行。保荐机构及其相关子公司后续将按要求进一步明确参与本次发行战略配售的具体方案，并按规定向上交所提交相关文件。

（二）发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况

发行人无控股股东、无实际控制人。除可能存在少量、正常的二级市场证券投资外，发行人或其重要关联方不存在持有本保荐机构或本保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情形。

（三）保荐机构的保荐代表人及其配偶、董事、监事、高级管理人员拥有发行人权益、在发行人任职等情况

本保荐机构的保荐代表人及其配偶不存在拥有发行人权益、在发行人任职等情况。除上述已说明的情形外，本保荐机构的董事、监事、高级管理人员不存在拥有发行人权益、在发行人任职等情形。

（四）保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况

发行人无控股股东、无实际控制人。本保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人重要关联方不存在相互提供担保或者融资等情形。

（五）保荐机构与发行人之间的其他关联关系

除上述说明外，本保荐机构与发行人不存在其他需要说明的关联关系。

四、本保荐机构内部审核程序和内核意见

（一）本保荐机构的内部审核程序

第一阶段：项目的立项审查阶段

投资银行业务立项委员会为立项决策机构，对于投资银行类项目是否予以立项进行决策，以保证项目的整体质量，从而达到控制项目风险的目的。

IPO 保荐主承销项目（含北交所公开发行并上市）设置两个立项时点。在正式协议签署之前，项目组提起项目立项申请；在辅导协议签署之前，项目组提起申报立项申请。项目组需对拟申请立项的项目进行尽职调查，认为项目可行后方可向招商证券投资银行委员会质量控制部（下称“质量控制部”）提出立项申请。质量控制部实施保荐项目的立项审查，对所有保荐项目进行立项前评估。

质量控制部负责组织召开立项会，每次立项会由 5 名立项委员参会，4 票（含）及以上为“同意”的，且主任委员未行使一票暂缓及否决权的，视为立项通过，2 票（含）及以上为“反对”的，或主任委员行使一票否决权的，视为立项被否决，其余情况视为“暂缓”。

第二阶段：项目的管理和质量控制阶段

质量控制部对投资银行类业务风险实施过程管理和控制，对投资银行类业务实施贯穿全流程、各环节的动态跟踪和管理，对投资银行类项目履行质量把关及事中风险管理等职责。

质量控制部负责组织对 IPO 项目进行现场核查，现场核查内容包括对项目尽职调查工作底稿进行审阅，对相关专业意见和推荐文件是否依据充分，项目组是否勤勉尽责进行判断，并最终出具现场核查报告。公司风险管理中心内核部（下称“内核部”）、风险管理中心风险管理部（下称“风险管理部”）及法律合规部认为有需要的，可以一同参与现场核查工作。

项目组进行回复后，质量控制部负责组织召开项目初审会就项目存在的问题与项目组进行讨论，公司风险管理中心内核部、风险管理部、法律合规部等公司内控部门可以参会讨论。

质量控制部根据初审会讨论结果、项目组尽职调查工作完成情况、工作底稿

的完备程度出具质量控制报告以及底稿验收意见，验收通过的方能启动内核会审议程序。

第三阶段：项目的内核审查阶段

本保荐机构实施的项目内核审查制度，是根据中国证监会对保荐机构（主承销商）发行承销业务的内核审查要求而制定的，是对所有保荐项目进行正式申报前的审核。

本保荐机构内核部根据《招商证券股份有限公司投资银行类业务内核委员会工作管理办法》及其附件《招商证券股份有限公司投资银行类业务内核委员会股权类业务内核小组议事规则》负责组织内核委员会股权类业务内核小组成员召开内核会议，拟申报项目须经股权类业务内核小组的全体有效表决票的 2/3 以上同意且主任委员未行使一票否决权或一票暂缓权的情况下视为表决通过，并形成最终的内核意见。

（二）本保荐机构对江苏鑫华半导体科技股份有限公司本次证券发行上市的内核意见

本保荐机构于 2025 年 12 月 5 日召开江苏鑫华半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市项目的投资银行类业务内核委员会股权类业务内核小组会议，本次应参会内核小组成员为吴晨、张杰、王俊龙、吴丹佳、王玲玲、孙世俊、周谦等 7 人，实际参会 7 人，达到规定人数。经全体参会委员投票表决，本保荐机构内核委员会股权类业务内核小组同意推荐江苏鑫华半导体科技股份有限公司首次公开发行股票申请材料上报上海证券交易所及中国证监会。

第二节 保荐机构的承诺

本保荐机构通过尽职调查和对申请文件的审慎核查，做出如下承诺：

（一）本保荐机构已按照法律、行政法规和中国证监会、上交所的相关规定，对发行人及其主要股东进行了尽职调查、审慎核查，同意推荐发行人证券发行上市，并据此出具本发行保荐书；

（二）有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会有关证券发行并上市的相关规定；

（三）有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（四）有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理；

（五）有充分理由确信申请文件和信息披露资料与其他证券服务机构发表的意见不存在实质性差异；

（六）保证所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；

（七）保证保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（八）保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范；

（九）自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施；

（十）自愿遵守中国证监会规定的其他事项。

第三节 对本次证券发行的推荐意见

一、发行人已就本次证券发行履行了《公司法》《证券法》及中国证监会规定的决策程序

（一）发行人董事会对本次证券发行上市的批准

2025年11月23日，发行人依法召开了第二届董事会第八次会议，审议通过《关于〈首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市方案〉的议案》《关于提请股东会授权董事会负责办理公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市相关事宜的议案》和其他相关议案，同意发行人本次发行上市的相关事项，并将上述议案提请发行人于2025年11月24日召开的2025年第六次临时股东会审议。

（二）发行人股东会对本次证券发行上市的批准、授权

2025年11月24日，发行人依法召开了2025年第六次临时股东会，审议通过《关于〈首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市方案〉的议案》《关于提请股东会授权董事会负责办理公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市相关事宜的议案》等与本次发行上市相关的议案。

二、发行人符合《证券法》规定的发行条件

（一）发行人具备健全且运行良好的组织机构

根据发行人《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》等内部控制制度及本保荐机构的核查，发行人已依法建立了股东会、董事会、独立董事、董事会秘书等公司治理体系。发行人目前有11名董事，其中4名为发行人选任的独立董事；董事会下设4个专门委员会，即：审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。

根据本保荐机构的核查以及发行人的说明、发行人审计机构毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏鑫华半导体科技股份有限公司内部控制审计报告》、发行人律师北京市竞天公诚律师事务所出具的《北京市竞天公诚律

师事务所关于江苏鑫华半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之法律意见书》，发行人设立以来，股东会、董事会能够依法召开，规范运作；股东会、董事会决议能够得到有效执行；重大决策制度的制定和变更符合法定程序。

综上所述，发行人具有健全且运行良好的组织机构，符合《证券法》第十二条第一款第（一）项的规定。

（二）发行人具有持续经营能力

根据发行人的说明、发行人审计机构毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（毕马威华振审字第 2600076 号）、发行人正在履行的重大经营合同及本保荐机构的核查，近三年发行人净资产快速增长，由 2022 年 12 月 31 日的 165,304.60 万元增长到 2024 年 12 月 31 日的 327,637.23 万元；发行人经营能力具有可持续性，最近三年主营业务收入分别为 102,018.61 万元、86,498.92 万元、106,701.69 万元；发行人具有良好的偿债能力，截至 2025 年 9 月 30 日，发行人资产负债率（合并）40.18%，流动比率 1.65，速动比率 1.36。发行人财务状况良好，具有持续经营能力，符合《证券法》第十二条第一款第（二）项的规定。

（三）发行人最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告

根据发行人的说明、发行人审计机构毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（毕马威华振审字第 2600076 号）、《江苏鑫华半导体科技股份有限公司内部控制审计报告》（毕马威华振审字第 2600075 号）及本保荐机构的核查，发行人报告期内财务会计报告被出具无保留意见审计报告，符合《证券法》第十二条第一款第（三）项规定。

（四）发行人及其控股股东、实际控制人最近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪

发行人无控股股东或实际控制人，根据相关机构出具的合规证明、发行人的企业信用报告、发行人及第一大股东的声明文件，并经检索相关政府主管部门、司法机关网站，发行人及其第一大股东最近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，发行人符合《证券法》第

十二条第一款第（四）项之规定。

（五）发行人符合中国证监会规定的其他条件

发行人符合经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件，具体情况请参见本节之“三、发行人符合《注册管理办法》有关规定”相关内容。

综上，本保荐机构认为，发行人本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件。

三、发行人符合《注册管理办法》有关规定

（一）符合《注册管理办法》第十条相关发行条件

1、发行人是依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司

根据《发起人协议》、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（毕马威华振审字第 2600076 号）、发行人历次股东会、董事会会议决议、发行人现行有效的《公司章程》、发行人律师北京市竞天公诚律师事务所出具的《北京市竞天公诚律师事务所关于江苏鑫华半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之法律意见书》《企业法人营业执照》等文件和本保荐机构的核查，发行人系由鑫华有限的全体股东作为发起人，以鑫华有限截至 2022 年 1 月 31 日经审计的净资产折股整体变更设立的股份有限公司，于 2022 年 3 月 30 日取得徐州市行政审批局核发的统一社会信用代码为 91320301MA1MCPLL8F 的《营业执照》，自鑫华有限设立之日起算，发行人持续经营时间已超过 3 年。

2、发行人具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责

根据发行人《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》、内部控制制度、历次“三会”会议通知、会议决议、会议纪要等文件及本保荐机构的核查，发行人已依法建立了股东会、董事会、独立董事、董事会秘书等公司治理体系。发行人目前有 11 名董事，其中 4 名为发行人选任的独立董事；董事会下设 4 个专门

委员会即：审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。

根据本保荐机构的核查以及发行人的说明、发行人审计机构毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏鑫华半导体科技股份有限公司内部控制审计报告》、发行人律师北京市竞天公诚律师事务所出具的《北京市竞天公诚律师事务所关于江苏鑫华半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之法律意见书》，发行人设立以来，股东会、董事会能够依法召开，规范运作；股东会、董事会决议能够得到有效执行；重大决策制度的制定和变更符合法定程序。

经本保荐机构及其他中介机构的辅导，并经发行人书面确认，发行人的董事和高级管理人员已经了解与股票发行上市有关的法律法规，知悉上市公司及其董事和高级管理人员的法定义务和责任，相关机构和人员能够依法履行职责。

经核查发行人的内部控制制度及其执行情况、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》（毕马威华振审字第 2600075 号），本保荐机构认为发行人的内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证财务报告的可靠性、生产经营的合法性、营运的效率与效果。

综上所述，发行人是依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司，具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责，符合《注册管理办法》第十条的规定。

（二）符合《注册管理办法》第十一条相关发行条件

根据查阅和分析毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（毕马威华振审字第 2600076 号）、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的《江苏鑫华半导体科技股份有限公司内部控制审计报告》（毕马威华振审字第 2600075 号）、发行人的重要会计科目明细账、重大合同、财务制度、经主管税务机关确认的纳税资料、关联交易的会议记录、同行业公司经营情况、内部控制制度及其执行情况、发行人的书面说明或承诺等文件和本保荐机构的核查，本保荐机构认为：

1、发行人会计基础工作规范，财务报表的编制和披露符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经

营成果和现金流量，最近三年财务会计报告由注册会计师出具无保留意见的审计报告。

2、发行人内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证发行人运行效率、合法合规和财务报告的可靠性，并由注册会计师出具无保留结论的内部控制审计报告。

综上所述，发行人会计基础工作规范，内部控制制度健全且被有效执行，符合《注册管理办法》第十一条的规定。

（三）符合《注册管理办法》第十二条相关发行条件

1、经核查发行人业务经营情况、主要资产、专利、商标等资料，实地核查有关情况，并结合主要股东调查表及对发行人董事和高级管理人员的访谈等资料。保荐机构认为，发行人资产完整，业务及人员、财务、机构独立，与主要股东及其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，不存在严重影响独立性或者显失公平的关联交易。

2、经核查发行人报告期内的主营业务收入构成、重大销售合同及主要客户等资料，发行人最近2年内主营业务未发生重大不利变化；经过对发行人历次股东（大）会、董事会决议资料、工商登记资料等文件的核查，本保荐机构认为发行人最近2年内董事、高级管理人员及核心技术人员均没有发生重大变化，主要股东和受主要股东支配的股东所持发行人的股份权属清晰；发行人不存在实际控制人，不存在最近2年实际控制人发生变更的情形，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷。

3、经核查发行人财产清单、主要资产的权属证明文件等资料，结合与发行人管理层的访谈、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（毕马威华振审字第2600076号）和发行人律师出具的法律意见书，保荐机构认为，发行人不存在主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，经营环境已经或者将要发生重大变化等对持续经营有重大不利影响的事项。

综上，发行人业务完整，具有直接面向市场独立持续经营的能力。发行人符合《注册管理办法》第十二条的规定。

（四）符合《注册管理办法》第十三条相关发行条件

保荐机构查阅了发行人的《营业执照》、主要业务合同、所在行业管理体制和行业政策，取得相关机构出具的工商、税务、社保、环保等方面合规证明文件，进行公开信息查询，并获取发行人主要股东、董事、高级管理人员提供的书面文件，查阅了董事、高级管理人员的无犯罪记录证明。

经核查，保荐机构认为：发行人生产经营符合法律、行政法规的规定，符合国家产业政策；发行人无控股股东、实际控制人，最近3年内，发行人及下属子发行人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为；发行人董事、高级管理人员不存在最近3年内受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见等情形。

综上，发行人符合《注册管理办法》第十三条的规定。

四、发行人符合《上市规则》规定的发行条件

本保荐机构依据《上市规则》对发行人是否符合首次公开发行股票并在科创板上市的条件进行了逐项检查，核查情况如下：

（一）发行后股本总额不低于人民币3,000万元且公开发行的股份达到发行人股份总数的10%以上

发行人目前的股本总额为人民币148,571.4288万元。根据发行人股东会决议，发行人拟向社会公开发行16,507.9366万股社会公众股，按发行16,507.9366万股测算，本次发行后发行人的股本总额将变更为165,079.3654万股，其中公开发行的股份将占发行人本次发行后股份总数的10%。发行人发行后股本总额不低于人民币3,000万元，且公开发行的股份达到发行人股份总数的10%以上，符合《上市规则》第2.1.1条的第（二）项、第（三）项条件。

（二）市值及财务指标符合《上市规则》有关规定

发行人本次上市选择的上市标准为《上市规则》第2.1.2条第四款，即“预

计市值不低于人民币 30 亿元，且最近一年营业收入不低于人民币 3 亿元”。

1、发行市值情况

根据发行人 2023 年 3 月外部融资投后估值、2025 年 9 月股权转让对应估值以及同行业 A 股上市公司估值情况，基于对发行人预计市值的预先评估，预计发行后总市值不低于 30 亿元。故发行人满足《上市规则》第 2.1.2 条第四款之预计市值标准。

2、发行人财务指标情况

根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（毕马威华振审字第 2600076 号），发行人最近一年营业收入为 110,964.15 万元，超过人民币 3 亿元。故发行人满足《上市规则》第 2.1.2 条第四款之营业收入标准。

综上，本保荐机构认为，发行人本次公开发行股票并在科创板上市符合《上市规则》规定的上市条件。

五、发行人符合科创板定位的说明

（一）发行人符合科创板行业领域要求

发行人主营业务为半导体产业用电子级多晶硅的研发、生产与销售。

根据《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，发行人所属行业属于“鼓励类”，第九条第 4 款“新材料”中“半导体、芯片用电子级多晶硅（包括区熔用多晶硅材料）”；根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，发行人所属行业属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”下的“C3985 电子专用材料制造”；根据《战略性新兴产业分类（2018）》，发行人所属行业属于“3 新材料产业”之“3.4 先进无机非金属材料”之“3.4.3 人工晶体制造”之“3.4.3.1 半导体晶体制造”。

根据《申报及推荐暂行规定》，发行人行业领域归属于第四条第（三）项“新材料领域”，符合科创板行业领域要求。

（二）发行人符合科创属性相关指标要求

发行人符合《科创属性评价指引（试行）》和《上海证券交易所科创板企业

发行上市申报及推荐暂行规定》相关科创属性指标要求，具体情况如下：

科创属性评价标准一	是否符合	指标情况
最近三年研发投入占营业收入比例 5% 以上，或最近三年研发投入金额累计在 8000 万元以上	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	2022 年至 2024 年，公司累计研发投入 18,184.84 万元，占最近三年累计营业收入比例为 5.46%，超过 8,000 万元，并超过 5%
研发人员占当年员工总数的比例不低于 10%	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	2024 年 12 月 31 日，公司研发人员 114 人，占当期末员工总数比例为 12.74%，超过 10%
应用于公司主营业务并能够产业化的发明专利 7 项以上	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	截至本发行保荐书签署日，应用于公司主营业务并能够产业化的发明专利 53 项，超过 7 项
最近三年营业收入复合增长率达到 25%，或最近一年营业收入金额达到 3 亿元	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	2024 年度营业收入 110,964.15 万元，大于 3 亿元

综上所述，发行人符合科创板定位要求，符合《科创属性评价指引（试行）》《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》等法规的规定。

（三）发行人科技创新能力突出

发行人的核心技术是发行人的主要竞争力之一。经过多年的技术实践与积累，发行人突破并优化了多项关键技术，自主研发了电子级多晶硅长周期稳定量产产业化技术、ppt 级氯硅烷痕量杂质纯化技术、高效 CVD 可控晶体沉积技术、硅棒洁净破碎、硅块洁净刻蚀等 11 项主要核心技术，构建了较高的技术壁垒，发行人拥有的改良西门子法电子级多晶硅生产工艺技术已处于国际先进水平。

依托在电子级多晶硅领域的技术积累，发行人积极承担国家及地方重大科技攻关任务。发行人是国家科技重大专项《极大规模集成电路制造装备及成套工艺》（02 专项）中《电子级多晶硅材料研发》的具体实施单位；发行人承接了工信部“国家工业强基工程”项目，已顺利完成验收；同时，发行人还承担了“江苏省工业和信息产业转型升级项目”“江苏省关键核心技术攻关项目”以及“江苏省重点研发计划项目”等多项省级重点科技专项。此外，发行人积极参与国家及行业标准体系建设，作为牵头单位完成了最新版《电子级多晶硅》（GB/T 12963-2022）国家标准的修订，并参与多项国家标准、行业标准的制定和修订工作。发行人是国家级专精特新“小巨人”企业。

（四）发行人主营业务符合国家产业政策的要求

发行人主要从事半导体产业用电子级多晶硅的研发、生产与销售。半导体制造产业链始于电子级多晶硅，至半导体硅片和晶圆制造，最终产出集成电路芯片用于终端产品。作为我国实现高水平科技自立自强的重要产业领域，半导体制造产业具有重大战略意义。发行人生产的电子级多晶硅是支撑整个半导体制造产业的关键基础材料，直接应用于半导体硅片与半导体用硅部件生产。

发行人所处的电子专用材料制造行业属于国家战略性、基础性产业，对支撑经济社会发展和保障产业链供应链安全具有重要作用，是我国重点鼓励发展的方向。近年来，国家陆续出台一系列政策措施，积极引导和支持该行业高质量、可持续发展。行业主要适用的法规及政策包括：

发布时间	发布单位	政策/文件名称	产业相关内容
2024年	工业和信息化部等七部门	《关于推动未来产业创新发展的实施意见》	推动有色金属、化工、无机非金属等先进基础材料升级，发展高性能碳纤维、先进半导体等关键战略材料，加快超导材料等前沿新材料创新应用
2023年	工业和信息化部	《重点新材料首次应用示范指导目录（2024年版）》	区熔用多晶硅材料属于先进半导体材料，被列入指导目录
2023年	工信部	《电子信息制造业2023-2024年稳增长行动方案》	面向个人计算、新型显示、VR/AR、5G通信、智能网联汽车等重点领域，推动电子材料、电子专用设备和电子测量仪器技术攻关；面向数字经济等发展需求，优化集成电路、新型显示等产业布局并提升高端供给水平，增强材料、设备及零配件等配套能力
2023年	工业和信息化部等六部门	《关于推动能源电子产业发展的指导意见》	面向光伏、风电、储能系统、半导体照明等，发展新能源用耐高温、耐高压、低损耗、高可靠IGBT器件及模块，SiC、GaN等先进宽禁带半导体材料与先进拓扑结构和封装技术，新型电力电子器件及关键技术
2022年	国务院	《关于印发“十四五”数字经济发展规划的通知》	提升核心产业竞争力。着力提升基础软硬件、核心电子元器件、关键基础材料和生产装备的供给水平，强化关键产品自给保障能力
2021年	工业和信息化部	《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023年）》	实施重点产品高端提升行动，面向电路类元器件等重点产品，突破制约行业发展的专利、技术壁垒，补足电子元器件发展短板，保障产业链供应链安全稳定
2021年	十三届全国人大四次会议	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》	在事关国家安全和发展的基础核心领域，制定实施战略性科学计划和科学工程。瞄准人工智能、量子信息、集成电路、生命健康、脑科学、生物育种、空天科技、深地深海等前沿领域，实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目。其中集成电路行业包括：集成电路设计工具、

发布时间	发布单位	政策/文件名称	产业相关内容
			重点装备和高纯靶材等关键材料研发，集成电路先进工艺和绝缘栅双极晶体管（IGBT）等
2020年	国家发改委、科技部、工信部、财政部	《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》	加快新材料产业强弱项。围绕保障微电子制造等重点领域产业链供应链稳定，加快在光刻胶、高纯靶材、高温合金、高性能纤维材料、高强高导耐热材料、耐腐蚀材料、大尺寸硅片、电子封装材料等领域实现突破
2020年	国务院	《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策》	国家鼓励集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业和软件企业，自获利年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率或减半
2019年	工信部	《关于政协十三届全国委员会第二次会议第2282号提案答复函》	持续推进工业半导体材料、芯片、器件及IGBT模块产业发展，根据产业发展形势，调整完整政策实施细则，更好地支持产业发展
2018年	工信部	重点新材料首批次应用示范指导目录（2018年版）	在先进半导体材料和新型显示材料下列示了大尺寸硅电极产品、大尺寸硅环产品，适用于重点新材料首批次应用保险补偿机制试点工作
2018年	财政部、国家税务总局、国家发展改革委、工信部	《关于集成电路生产企业有关企业所得税政策问题的通知》	对满足要求的集成电路生产企业实行税收优惠减免政策，符合条件的集成电路生产企业可享受前五年免征企业所得税，第六年至第十年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止的优惠政策

发行人的主要产品和业务受到国家政策的鼓励与支持，符合产业政策和国家经济发展战略。

综上所述，发行人所属行业领域和科创属性皆符合科创板定位要求，符合《科创属性评价指引（试行）》《申报及推荐暂行规定》等法规的规定。

六、发行人存在的主要问题和风险

本着勤勉尽责、诚实守信的原则，经过全面的尽职调查和审慎的核查，根据发行人的有关经营情况及业务特点，保荐机构特对发行人以下风险做出提示和说明：

（一）发行人在国内乃至国际市场与国际厂商竞争面临的不确定性风险

公司目前主要竞争对手为德国瓦克、美国 Hemlock、日本德山等国际厂商，该等国际厂商已经历数十年乃至上百年的积累和发展，在技术积淀、产品品类、客户议价能力、经营规模、资本实力等方面具有优势，在全球市场已形成寡头垄断竞争格局。公司目前是国内主要的半导体产业用电子级多晶硅生产企业，也是12英寸硅片领域电子级多晶硅大规模稳定供应的唯一国产供应商，国内市场占

有率超过 50%，国内市场其余份额和国际市场目前仍基本由境外厂商占据。截至目前，公司已成功进入国际一线硅片厂商供应链，包括环球晶圆、SK Siltron 等国际前五大硅片厂商中的两家，但销售规模仍较小。

在国内，公司要继续提升市场占有率，面临国际厂商更强阻力；在国外，电子级多晶硅国际厂商已与全球五大硅片厂商长期深度合作（包括销售长单、控参股关系、持续产品开发磨合等），公司面临不利竞争态势。此外，公司还需要不断扩充产品品类，并持续经历客户验证、市场开拓的过程。在上述竞争过程中，如果公司不能持续维持技术优势、有效保持和开拓境内外战略客户、降低成本、扩充产品品类，可能导致公司竞争力下降，而无法在国内市场维持优势，或在国际市场提升收入规模，从而难以实现公司经营目标。

（二）经营业绩波动的风险

1、经营业绩受半导体行业波动影响的风险

公司所在半导体行业受宏观经济形势、下游终端需求等因素影响而具有一定的周期波动。根据 WSTS 统计，2024 年全球半导体市场销售额为 6,305.49 亿美元；2025 年，随着新兴市场需求增加、全球经济形势企稳、通胀有所放缓，以及各国持续出台半导体产业支持政策，全球半导体市场回暖，预计全年销售总额为 7,008.74 亿美元，同比增长 11.15%。报告期内，公司主营业务收入和主营业务毛利受半导体行业波动影响而呈现出一定波动。半导体行业的周期性波动受多种因素综合影响，具有一定不确定性，若由于宏观经济低迷、下游行业需求持续放缓、半导体行业政策出现不利变化、市场竞争加剧等因素而出现主要产品价格或销量下降等不利情况，公司收入、利润存在受半导体行业整体波动而降低的风险。

2、经营业绩受副产品市场价格波动影响的风险

公司业绩受到副产品太阳能级多晶硅价格波动的影响，公司在生产电子级多晶硅过程中，由于生产工艺特征，不可避免会产生部分副产品，等级未达到电子级，但可以应用于新能源领域，因此作为太阳能级多晶硅销售。公司副产品收入核算为其他业务收入，公司不会主动拓展副产品销售市场，主要由客户主动询购，公司参考市场公开价格进行销售。太阳能级多晶硅市场价格波动较大，在 2022

年至 2023 年经历了较为罕见的价格大幅波动。2022 年太阳能级多晶硅市场价格处于历史高位，且远高于历史均值，导致公司当年净利润基数较高；2023 年太阳能级多晶硅市场价格快速下跌，较 2022 年最大跌幅近 80%。因而，公司副产品相关收入及利润波动较大，进而可能导致整体业绩波动。

公司通过技术提升已将副产品产出率降至较低水平，且副产品太阳能级多晶硅市场价格已处于历史低位。但如果未来副产品太阳能级多晶硅市场价格再次出现大幅波动，仍可能在一定程度上影响公司整体业绩的波动，提醒投资者关注相关风险。

3、内蒙古鑫华投产后新增折旧摊销影响经营业绩的风险

内蒙 10,000 吨/年电子级多晶硅产线总体投资规模较高，内蒙产线投产后，2025 年 1 月至 9 月，月平均折旧额为 1,588.10 万元，对归母净利润影响额为每月 952.86 万元，对公司未来的经营业绩存在一定影响。若未来产业政策或市场环境等因素发生重大不利变化，则新增折旧摊销可能对本次募集资金投资项目效益造成不利影响，继而对公司未来的经营业绩产生不利影响。

（三）毛利率波动的风险

报告期内，公司综合毛利率分别为 23.81%、15.63%、22.44%和 24.56%，主营业务毛利率分别为 20.55%、16.84%、23.10%和 25.08%，存在一定波动。

2023 年度，公司综合毛利率水平有所下滑，主要系受到半导体行业波动以及副产品太阳能级多晶硅市场价格大幅下降的综合影响。公司电子级多晶硅产品中，质量要求更高的 P 级产品价格相对稳定，而 S 级产品价格受行业影响有所下降。此外，公司 2023 年 7 月产线进行升级改造，期间产线相关折旧、人工等停工损失提高了本期产品单位成本。前述因素导致 2023 年主营业务毛利率较上期有所下降。公司电子级多晶硅副产品的价格主要跟随太阳能级多晶硅市场价格而波动，2023 年太阳能级多晶硅市场价格大幅下跌导致其他业务毛利率从 36.91%下降至 2.80%。

未来若公司不能保持较好的技术研发、成本控制和客户开发能力，产品竞争力有所下降，半导体市场持续低迷或继续下行，S 级电子级多晶硅产品价格继续下降，将影响公司主营业务毛利率；若副产品太阳能级多晶硅市场价格持续下降

或保持低位，公司将面临其他业务毛利率继续下滑或持续较低的风险。前述因素均会导致公司综合毛利率波动，进而可能给公司生产经营活动带来不利影响。

（四）无实际控制人风险

公司无控股股东和实际控制人。截至本发行保荐书签署日，公司第一大股东合肥国材叁号及其一致行动人中建材新材料基金持股比例合计为 25.55%，第二大股东集成电路基金持股比例为 20.62%，均未超过 30.00%，并且合肥国材叁号和集成电路基金之间不存在一致行动关系。公司的单一股东依其持有的股份所享有的表决权不足以对股东会的决议产生决定性影响，单一股东在董事会中提名的董事不足以对董事会的决议产生决定性影响，无法单独控制公司的董事会，也无法单方面决定公司及其下属公司的经营决策。充分制衡的股权结构有利于提高决策的科学性，但也可能影响公司的决策效率，在公司需要迅速做出重大经营、投资决策时，可能导致贻误发展机遇。此外，公司股权相对分散，使得公司未来有可能成为被收购对象，不排除上市后现有或新增股东通过增持公司股票导致公司股权结构发生变化，并可能导致董事会成员构成发生变化，甚至导致公司控制权发生变化。该等公司治理结构的变化可能会对公司经营管理和业绩的稳定性等带来不利影响。

（五）关联采购金额较大的风险

报告期内，发行人向中能硅业购买商品及接受劳务金额分别为 45,837.97 万元、20,891.72 万元、16,019.91 万元和 14,000.03 万元，占报告期各期营业成本比重分别为 47.21%、26.17%、18.62%和 13.89%。发行人目前拥有 8,000 吨/年徐州产线和 10,000 吨/年内蒙产线两大生产基地，报告期内发行人与中能硅业之间的采购主要是发行人的徐州产线向其委托加工三氯氢硅、采购电力等。

报告期期初，发行人徐州产线生产所需三氯氢硅主要委托中能硅业加工，2022 年及 2023 年向中能硅业采购三氯氢硅金额分别为 28,564.90 万元、3,384.69 万元，占各期营业成本的比例分别为 29.42%、4.24%。发行人徐州产线自建三氯氢硅生产线于 2022 年底建设完成并开始投入使用，2023 年三氯氢硅关联采购金额及占比大幅下降。随着发行人徐州产线的三氯氢硅生产线逐渐达到稳定满产状态，2023 年 5 月后已不再委托中能硅业加工三氯氢硅。2025 年 9 月，因公司冷

氢化产线停产检修，公司临时向中能硅业采购少量三氯氢硅，采购金额 600.66 万元。

发行人徐州产线建设时，由中能硅业和集成电路基金共同出资，中能硅业以实物产线注资，出资产线配套的原始电力设计方案和电力配套设施已固定。因此，发行人徐州产线的部分电力通过中能硅业采购，报告期内采购金额分别为 15,793.53 万元、14,264.94 万元、12,633.81 万元和 11,263.75 万元，占报告期内发行人营业成本比重分别为 16.27%、17.87%、14.68%和 11.18%。发行人徐州产线向中能硅业采购电力价格参照中能硅业向国家电网采购的电度用电价格（加成一定金额容/需量费）确定，定价公允。如果未来由于不可抗力等因素，导致前述中能硅业电力供应出现不稳定波动甚至中断情形，发行人需进行供电系统切换并重新配置电力设备等，可能导致徐州产线在一定期间内生产稳定性受到影响，并导致未来用电成本有所上升。发行人与中能硅业目前签署的能源供应合同有效期至 2036 年底。

七、发行人的发展前景评价

半导体行业是现代信息产业的基础和核心产业之一，是支撑国民经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业，也是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量。近年来，随着国家经济质量的提升，半导体行业对于国民经济发展的战略意义更加凸显，国家及产业政策密集出台。国家及产业政策的大力支持为行业创造了良好的政策环境和企业发展基础，为半导体行业发展指引了方向。国内部分优质的半导体企业得益于各项扶持政策，进入快速成长通道，在其各自细分领域实现国产替代，并开始与全球领先企业同台竞争，在全球市场上占有一席之地。

电子级多晶硅对产品纯度和杂质控制的要求极为苛刻，纯度需达到 11N（即 99.999999999%）以上。当硼、磷或其他金属元素作为杂质存在于多晶硅中时，制成的硅片产品质量难以控制，因此需要极高的多晶硅纯度。制造电子级多晶硅的过程中去除硼、磷或其他金属杂质一直是国内电子级多晶硅材料领域的技术瓶颈。此前，国内高纯度硅料一直处于稀缺状态，并被外资厂商垄断。包括德国瓦克、美国 Hemlock、日本德山等全球几大厂商常年垄断这一技术。

发行人自成立以来，便以“填补国内半导体级多晶硅国产化空白”战略目标为指导，坚持以科技创新为核心，致力于关键技术的研究和开发，先后建成徐州 5,000 吨/年（后扩产至 8,000 吨/年）和内蒙 10,000 吨/年电子级多晶硅生产线。发行人的大规模半导体产业用电子级多晶硅打破了国外技术、市场的垄断，填补了国内空白。发行人电子级多晶硅各项关键指标已全面达到国际先进水平，国内外主流客户验证也已顺利通过，产品应用领域实现了从 12 英寸硅片、6-8 英寸硅片至小尺寸硅片及硅部件的全覆盖，保障国产硅片及硅部件产业的正常运行和发展。根据中国电子材料行业协会半导体材料分会统计，在 2024 年国内集成电路用高纯电子级多晶硅市场占有率排名中，发行人位居国内市场第一。发行人目前在手订单充足，随着技术水平不断提高和产品性能持续升级，发行人产品的市场占有率将不断提升，具有广阔的市场前景。

八、保荐机构、发行人在本次项目中直接或间接有偿聘请第三方的核查意见

根据《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告[2018]22 号）等规定，招商证券就本项目中招商证券及服务对象有偿聘请各类第三方机构和个人（以下简称“第三方”）等相关行为的核查意见如下：

（一）招商证券在本次项目中直接或间接有偿聘请第三方的情况

截至本发行保荐书出具之日，招商证券在江苏鑫华半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市项目中不存在直接或间接有偿聘请第三方的行为。

（二）发行人在本次项目中直接或间接有偿聘请第三方的情况

发行人在本次项目中直接或间接有偿聘请第三方的相关情况如下：

1、发行人聘请招商证券股份有限公司作为本项目的保荐机构，聘请北京市竞天公诚律师事务所作为本项目的法律顾问，聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为本项目的审计机构、验资机构及验资复核机构，聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为本项目的验资机构，聘请上海东洲资产评估有限公司担任资产评估机构。

2、除上述依法聘请的证券服务机构外，发行人存在直接或间接有偿聘请其他第三方的行为，具体情况如下：（1）发行人聘请了北京荣大科技股份有限公司和北京荣大商务有限公司北京第二分公司提供专业图文材料制作与信息咨询服务，协助发行人完成本次发行上市工作；（2）发行人聘请了上海和诚创芯企业管理咨询有限公司和尚普咨询集团有限公司对本次发行的募集资金投资项目提供可行性分析服务，协助发行人完成本次发行上市工作；（3）发行人聘请了内蒙古天柏生态环境咨询有限公司、内蒙古百瑞兴环保科技有限责任公司、江苏方正环保集团有限公司和江苏苏辰工程咨询有限公司对本次发行的募集资金投资项目环境影响评价技术服务，协助发行人完成本次发行上市工作；（4）发行人聘请了渥美坂井法律事务所为本次发行上市提供境外法律服务；（5）发行人聘请了北京思必锐翻译有限责任公司提供申报文件外文资料翻译服务，协助发行人完成本次发行上市工作；（6）发行人聘请了深圳市九富投资顾问有限公司提供投资者关系顾问服务，协助发行人完成本次发行上市工作；（7）发行人聘请了北京案牍玛卡科技有限公司为发行人提供股东信息查询等服务，协助发行人完成本次发行上市工作。

（三）结论性意见

综上，经核查，本保荐机构认为：

1、招商证券在本次项目中不存在直接或间接聘请第三方机构的行为，符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告[2018]22号）的相关规定。

2、发行人在本项目中依法聘请了招商证券股份有限公司作为本项目的保荐机构，聘请北京市竞天公诚律师事务所作为本项目的法律顾问，聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为本项目的审计机构、验资机构及验资复核机构，聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为本项目的验资机构，聘请上海东洲资产评估有限公司担任资产评估机构，聘请行为合法合规。除上述依法聘请的证券服务机构外，发行人在本项目中，存在直接或间接有偿聘请其他第三方的行为，上述第三方皆是为发行人提供首次公开发行并在科创板上市过程中所需的服务，聘请其他第三方具有必要性，其聘请行为合法合规，符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告

[2018]22号)的相关规定。

九、对本次证券发行的推荐意见

综上所述，本保荐机构认为，发行人的本次发行符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》《上市规则》等有关规定，本保荐机构认真审核了全套申请材料，并对发行人进行了实地考察。在对发行人首次公开发行股票并在科创板上市的可行性、有利条件、风险因素及对发行人未来发展的影响等方面进行了深入分析的基础上，本保荐机构认为发行人符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》《上市规则》等相关文件规定，同意保荐江苏鑫华半导体科技股份有限公司申请首次公开发行股票并在科创板上市。

(以下无正文)

附件：招商证券股份有限公司保荐代表人专项授权书

(本页无正文,为《招商证券股份有限公司关于江苏鑫华半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之发行保荐书》之签章页)

项目协办人

签名: 赵国伟

赵国伟

保荐代表人

签名: 姜 博

姜博

签名: 吴宏兴

吴宏兴

保荐业务部门负责人

签名: 梁战果

梁战果

内核负责人

签名: 吴 晨

吴晨

保荐业务负责人

签名: 刘 波

刘波

保荐机构总经理

签名: 朱江涛

朱江涛

保荐机构法定代表人、董事长

签名: 霍 达

霍达



2026年 2月 9日

附件：

招商证券股份有限公司保荐代表人专项授权书

中国证券监督管理委员会、上海证券交易所：

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及有关文件的规定，我公司同意授权姜博、吴宏兴两位同志担任江苏鑫华半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐代表人，负责该公司发行上市的尽职调查及持续督导等保荐工作事宜。

特此授权。

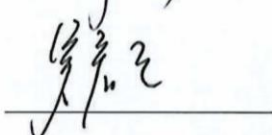
（本页以下无正文）

(本页无正文，为《招商证券股份有限公司保荐代表人专项授权书》之签章页)

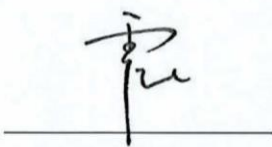
保荐代表人签字：姜 博



吴宏兴



法定代表人签字：霍 达



招商证券股份有限公司

2026年 2月 9日